



2023年6月26日

各 位

上場会社名 株式会社 ヒラノテクシード
代表者 取締役社長 岡田 薫
(コード番号 6245)
問合せ先責任者 取締役兼執行役員 原 昌史
総務部門管掌
(TEL 0745-57-0681)

シーメンス株式会社との DX 推進に関する基本合意書締結に関するお知らせ

バッテリー製造装置を始めとした標準化やデジタル化に向けたDX戦略の一環として、当社はシーメンス株式会社との間で、本日基本合意書を締結しましたのでお知らせ致します。

当社は、長期ビジョン 2030 を策定し、「塗工機のグローバル・リーディングカンパニー」を目指し収益性並びに企業価値の向上に取り組んでおります。

その基本方針のひとつである「スマートファクトリー技術の追求」では、自動運転やデジタルツインを中心として、予知保全・トラブルシューティングなど、顧客工場での生産性向上に資する技術の強化を重点テーマとしています。

シミュレーションや TIA (Totally Integrated Automation))を含む 包括的なデジタルエンタープライズソリューションと、欧州を始めとする大規模工場構築で培った経験と知識を豊富に持つシーメンス株式会社をパートナーとし、その実現を加速させて参ります。

1. 締結日

2023年6月26日

2. 基本合意書締結先の概要

| | |
|------------|--|
| (1) 会社名 | シーメンス株式会社 |
| (2) 住所 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 |
| (3) 代表者の氏名 | 代表取締役社長 兼 CEO 堀田 邦彦 |
| (4) 事業概況 | 産業オートメーション、PLM ソフトウェア、ドライブテクノロジー、産業ソリューションに関する製品、サービス、ソリューションの輸入、販売。 |
| (5) 資本金 | 43 億 3,630 万 4,000 円 |
| (6) 設立年月日 | 2001 年 12 月 20 日 |
| (7) URL | https://www.siemens.com/jp |

3. 今後の見通し

本件が当社の今期業績に与える影響は軽微であります。中長期的に当社の業績の向上に資するものと考えております。なお、今後の状況により公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上